

# AUROMEX®

## TECHNICAL INSTRUCTIONS

### DATA SHEETS

## CUPOMEX HSB-1000 高速光亮酸銅配方

### 簡介：

AUROMEX CUPOMEX HSB-1000 為一新改良之高速硫酸銅配方，鍍層出光率快，覆蓋力強及高平整性能。配方選用全新組合的硫酸銅光亮劑，使電鍍光亮範圍寬闊，操作溫度較廣。

### 特性：

- \* 鍍層延展性強。
- \* 高亮度及平整性能。
- \* 鍍層覆蓋力特強。
- \* 鍍液穩定及雜質容忍度高。
- \* 光劑消耗低及易於操作。

### 鍍液成份及操作條件：

	<u>單位</u>	<u>最佳</u>	<u>範圍</u>
硫酸銅 (CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O)	克/公升	200	160-220
銅金屬含量	克/公升	50	40-55
硫酸 (C.P. Grade S.G.1.84)	克/公升	65	50-70
氯離子 (Cl <sup>-</sup> )	毫克/公升	40	20-80
CUPOMEX HSB-1000 A 光劑	毫升/公升	0.5	0.5-1.5
CUPOMEX HSB-1000 B 光劑	毫升/公升	0.5	0.5-1.5
CUPOMEX HSB-MU. 開缸光劑	毫升/公升	10	5-15
CUPOMEX HSB-W.A. 潤濕劑	毫升/公升	2	1-5
比重	°Be	20	20-22
操作溫度	°C	25	20-35
陽極		磷銅 (含 0.1-0.3% 磷)	
電流密度 (陰極)	安培/平方分米	3	2-5
(陽極)	安培/平方分米	2	1-3
陽極：陰極比例		2-3:1	
攪拌		空氣攪拌	
過濾		可配備連續過濾	
鍍率 (25°C, 4-5 安培/平方分米計算)		約 1 分鐘 1 微米	

P.1

AUROMEX®

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117

## 鍍液配製及維護：

- 1) 本產品需於鍍液配備完成後及作活性炭，低電處理後才可加入，以免損耗。
- 2) 當鍍層中出現毛刺或高電流位置燒焦現象時，可在每公升鍍液中加入 **CUPOMEX HSB-1000 A** 光澤劑 0.5 毫升。
- 3) 當鍍層光亮度減低，鍍件在低電流位置呈現暗紅色時，可在每公升鍍液中加入 **CUPOMEX HSB-1000 B** 光澤劑 0.5 毫升。
- 4) 爲了保證光銅鍍層與光亮鎳層間的結合力，在鍍光亮鎳之前可以採用銅活化工藝，將鍍件浸入活化酸中 5-10 秒，清洗後便可鍍光鎳。
- 5) 鍍液使用時間較長後，會產生有機分解物，直接影響鍍層性能，如鍍層暗紅，低電流發霧等，鍍液需進行淨化處理，其方法如下：  
在攪拌下加入 3-5 克/公升活性炭，再將鍍液加溫至 60-70°C 及連續攪拌 1 小時，後靜止過夜再進行過濾，經處理後的鍍液只需重新加入 **CUPOMEX HSB-1000** 光亮劑後即可用。
- 6) **CUPOMEX HSB-1000** 光劑補充量可參照以下數據：  
每 10000 安培小時約消耗 **CUPOMEX HSB-1000 A** 750 毫升  
**CUPOMEX HSB-1000 B** 750 毫升